



Автоматическая установка монтажа флип-чипов методом термокомпрессии AD9312



Установка AD9312 предназначена для производства сложных многокристальных модулей с помощью термокомпрессионного метода монтажа флип-чипов. В установке могут быть реализованы следующие технологии:

- Термокомпрессия с использованием непроводящих паст (TC NCP)
- Термокомпрессия с использованием непроводящих пленок (TC NCF)
- Термокомпрессионная пайка с использованием флюса (с последующей заливкой под кристалл). Флюс наносится распылением или окунаем

AD9312 способна устанавливать до 4 типов кристаллов в одном цикле и может применяться для сборки изделий по технологии 2.D/3D интеграции: **кристалл на пластине** (Chip to Wafer, C2W); **кристалл на подложке** (Chip on Substrate, CoS); **кристалл на кристалле** (Chip on Chip, CoC).

Параметры	AD9312
Точность монтажа	$\pm 2,0$ мкм, $\pm 0,01^\circ$, 3σ
Производительность	До 2000 кристаллов в час (1,8 сек/кристалл)
Габариты кристаллов	От 1,0 x 1,0 до 30 x 30 мм
Толщина кристаллов	От 50 мкм
Диаметр пластин	До 300 мм
Типы подложек	Платы, пластины, выводные рамки
Габариты подложек	Длина от 100 до 300 мм; ширина от 30 до 160 мм; толщина от 0,08–2,0 мм; пластина до 300 мм
Рабочая область	До 300 x 160 мм или 300 мм диаметр
Подогрев рабочего стола	До 200°C $\pm 5^\circ$ C (опция)
Тип эжектора	Карусельный, до 4 эжекторов
Сила прижима	0,1–300 Н
Подогрев инструмента монтажа кристалла	До 450°C, 300°C/сек
Электропитание	380 В; 50 Гц; 3,4 кВт
Сжатый воздух	Не менее 6 бар, 1250 л/мин (азот 780 л/мин)
Габариты с загрузчиками и разгрузчиками, вес	4400 x 2150 x 2570 мм, 6850 кг

ООО «ЛионТех-С»
mail@liontech.ru



Звонок по России бесплатный:

8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

www.liontech.ru

*Технологическое оборудование и расходные материалы
для производства электроники*